

「2023 マイクロエレクトロニクスショー」 出展のお知らせ

昨年引き続き東京ビックサイトで2023年5月31日（水）～6月2日（金）に開催される
「[2023マイクロエレクトロニクスショー](#)」に当社製の高機能接着剤を出展いたします。

当社の高機能接着剤は、富士通の半導体実装で培った接着材料の設計技術をもとにして、お客様のご要望にカスタマイズした高機能な接着材料です。

本展示会では、「低温・短時間硬化の接着剤」や「高密着型軟質接着剤」などのラインナップを揃えてお待ちしておりますので、是非とも当社ブースにお立ち寄りください。

開催期間： 2023年5月31日（水）～6月2日（金）

会場： 東京国際展示場（東京ビッグサイト）
・ **小間番号：東展示棟 2H-16**
・ **出展ゾーン：eX-tech**

公式サイト： <https://jiep.or.jp/event/jpcashow.html>



■ 出展材料

低温超短時間硬化接着剤	50℃/20分 or 80℃/2分で完全硬化、作業時間の短縮や低応力接着の効果に寄与
高密着型軟質接着剤	シリコン並の柔らかさで、かつ、エポキシ並の高密着強度を両立
超短時間硬化接着剤	わずか3秒（190℃）で完全硬化
接着剤補強型Sn-Biはんだペースト	180℃以下の低温リフロー接合可能で、Sn-Ag-Cuはんだと同等以上の特性